



WÜRTH ELEKTRONIK UNIVERSITY MARKETING



WÜRTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT

LIEBE
PROFESSOR:INNEN,
LEHRER:INNEN,
WISSENSCHAFTLICHE
MITARBEITER:INNEN,

vielen Dank für das Interesse
an unseren Mehrwerten für Ihre
Bildungsinstitution. In diesem
Dokument finden Sie unser zusam-
mengefasstes Angebot. Kommen
Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit!

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
University Marketing

INHALTSVERZEICHNIS.

WORUM GEHT ES?

Würth Elektronik eiSos Wer sind wir?.....	04
01 Kostenlose und praxisnahe Gastvorträge und Workshops	05
Vertrieb	07
General Würth Elektronik eiSos	08
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	09
Leistungen	12
Schnittstellen	14
Frequenz	15
Elektromechanik.....	16
Funk und Sensorik	20
02 Exkursionen.....	21
03 Zusätzliche Lehrmittel und technische Unterstützung	24
Kostenlose Bauteile für Lehre und Praxis	25
DesignKits für Labore.....	25
Technische Unterstützung vor Ort.....	25
Fachbücher.....	25
04 Vielfältige Studierendenprogramme	26
Kontakt Daten	29

WÜRTH ELEKTRONIK eiSos.

WER SIND WIR?

Die Würth Elektronik eiSos ist einer der führenden Hersteller von elektronischen und elektromechanischen Bauteilen in Europa. Das Produktportfolio umfasst: EMV-Komponenten, EMV-Filter, Kondensatoren, Induktivitäten, HF-Induktivitäten und LTCC-Bauteile, Widerstände, Quarze, Oszillatoren, Transformatoren, Bauelemente für Schaltungsschutz, Power Module, LEDs, Steckverbinder, Schalter & Taster, Hochstromanschlüsse, Verbindungstechnik, Funkmodule und Sensoren.

Wir sind in über 50 Ländern auf der Welt aktiv. Durch 16 Fertigungsstandorte weltweit garantieren wir kompetente Design-in Unterstützung sowie eine schnelle Bemusterung und Belieferung mit Bauelementen rund um den Globus.



01

LUST AUF
NEUEN INPUT?
GASTVORTRÄGE
UND WORKSHOPS
VON UNSEREN
SPEZIALIST:INNEN.



WÜRTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT

GASTVORTRÄGE UND WORKSHOPS.

KOSTENLOS UND PRAXISNAH.

Ergänzend zur Lehre an Universitäten, Hoch- und Technikerschulen bieten wir seit gut 10 Jahren unsere Gastvorträge an. Es handelt sich hierbei um Fachvorträge zu brandaktuellen Themen aus der Praxis von Ingenieur:innen und Techniker:innen innerhalb der Elektronik und Elektromechanik.

Anpassungen und Kombinationen sind gerne möglich. Sprechen Sie uns an!



Workshop



Vortrag



Dauer

MÖGLICHER ABLAUF GASTVortrag

- 10 – 15 Minuten Unternehmen / Einstiegsmöglichkeiten
- 45 – 90 Minuten Fachlicher Vortrag Teil I
- 15 – 30 Minuten „Get together“ Pause
- 45 – 90 Minuten Fachlicher Vortrag Teil II



GASTVORTRÄGE UND WORKSHOPS.

THEMENÜBERSICHT

VERTRIEB

Nr. 1.0 Technischer Vertriebsaußendienst



1,5 h

Warum Technischer Vertrieb kein Klinkenputzen ist – Menschen – Produkte – Lösungen

- Aufgaben
- Qualifikationen
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- Herausforderungen

Nr. 1.1 Telefontraining



4 h

Was macht uns im Telefonvertrieb erfolgreich?

- Was bedeutet aktive Gesprächsführung
 - Wer fragt der führt
 - Die richtigen Fragen stellen
 - Offene-/geschlossene Fragen
 - Suggestivfragen
 - Aktives Zuhören
 - Wann läuft ein Gespräch schief?
 - Eintauchen in die Praxis – Rollenspiele
- > **Hinweis: Gut kombinierbar mit einer Laborexperience an unserem Standort in Waldenburg**

Nr. 1.2 Mitreise im Außendienst



1 d

Ein Tag in der Rolle eines Außendienstmitarbeitenden

- Treffen mit dem Außendienst an einem definierten Ort
- Besprechung der anstehenden Kundentermine
- Gemeinsame Fahrt im Firmenwagen zu den Kunden
- Design-in bei 3-4 Kundenterminen
- Kennenlernen unserer Produkte und Vertriebsausstattung (Hard- und Software)
- Nachbereitung der Kundentermine

Nr. 2.0 Grundlagen Magnetismus (Ferritmaterialien)



- Einleitung
- Ferro-, Ferrimagnetismus
- Permeabilität Magnetisches Feld
- Hysteresis
- Verlustwinkel, komplexe Permeabilität
- Verlustfaktor, Güte, Messverfahren
- Impedanz einer Spule mit Ferritkern
- Variation der Permeabilität
- Nanokristallines Material

Nr. 2.1 ESD Schulung DIN 61340



- Was ist ESD, wie entsteht es, wie schützt man sich?
- EPA-Zutrittsberechtigung möglich
- Schutzbauteile und Möglichkeiten auf der Platine
- Live-Messungen und kleine Experimente zur Veranschaulichung der Effekte

Nr. 2.2 **REDEXPERT**



- Funktionen der Software
- Verlustberechnung
- Vorteile für die Entwicklung
- Weitere Bauteilauswahlmöglichkeiten über die Homepage (z. B. Analog IC Selector)
- Produktsuche mit „One Click Selection Guide“
- 3D-Dateien, S-Parameter – wo sie zu finden sind

Nr. 2.3 Lötseminar



- Einführung in das Thema Löten
- Praktisches Löten am Arbeitsplatz für Entwickler und Tipps am LötKolben
- THR-Löten / Pin-in-Paste-Verfahren
- Besichtigung der Fertigung, Fehlervermeidung, fertigungsbezogene Themen

Nr. 2.4 Lötworkshop für Anfänger



- Einführung und Gefahrenhinweise
- Schritt für Schritt Anleitung
- **Workshop: Gemeinsames Löten**

Nr. 2.5	Eigenschaften und praktische Anwendung von Kondensatoren		 2 h
■ MLCC: Eigenschaften, LC-Filter ■ Elektrolytkondensatoren: Eigenschaften, Abwärtswandler ■ Folienkondensatoren: Eigenschaften, Netzfilterauslegung			

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV)

Nr. 3.0	Grundlagen EMV (Aufbauseminar zu „2.0 Grundlagen Magnetismus“)		 1,5 h
■ Begriffe in Zusammenhang mit EMV ■ Frequenz, Wellenlänge ■ Störabstand ■ Gleichtakt, Gegentakt ■ Signalübertragungsarten ■ Kopplung zwischen Stromkreisen ■ Einfügedämpfung ■ Entstörung ■ Identifikation der Koppelpfade ■ Gleichtaktfilterbauteile ■ Stromkompensierte Drossel ■ Gegentaktfilterbauteile ■ Dimensionierung einer Filterdrossel ■ EMV-Filter-Topologien			

Nr. 3.1	EMV Zertifizierungen		 0,75 h
■ EMV Direktiven 2014/30/EU ■ Harmonisierte Normen und zugehörige Tests			

Nr. 3.2	Filtertopologien		 0,5 h
■ Übersicht ■ Filterplatine ■ Messaufbau ■ LTspice-Modell ■ Einfügedämpfung verschiedener Filtertopologien			

Nr. 3.3 Kabelferrite



- Standard Klappferrit
- Klappferrite mit definiertem Luftspalt
- Klappferritserien
- Ferritringe, Ferrithülsen
- Beispiel Ferritauswahl

Nr. 3.4 Leiterplattenferrite



- Aufbau und Grundlagen
- Beispiel zur Auswahl
- Impulsbelastung und Derating
- Verhalten der Impedanz

Nr. 3.5 Auswahl von Gleichtaktdrosseln



- Anwendungen und Bauformen
- Parasitäre Effekte zw. den Wicklungen
- Messung und Berechnung der Streuinduktivität
- Richtige Auswahl der stromkompensierten Drossel mit Livemessung
- Sättigungseffekte
- Vom Klappferrit zur stromkompensierten Drossel

Nr. 3.6 Überspannungsschutz



- Grundlagen
- Schutz vor Blitzstrompulsen (Surge)
- IEC 61000-4-5
- Übersicht der Schutzelemente
- Varistor allgemein, Auswahl
- Power TVS
- Platzierung von Schutzbauteilen
- Produkte von WE
- Schutz vor elektrostatischer Entladung
- IEC 61000-4-2
- Schutzmaßnahmen
- TVS-Diode
- Produkte von WE

Nr. 3.7 Schirmmaterialien



- Grundlagen
- Schirmöffnungen
- Schirmungslösungen

Nr. 3.8 EMV Design Tipps



- Koppelpfade
- Massekonzepte
- Lagenaufbau
- Filterkondensator- und Via-Platzierung
- Filterplatzierung
- Layout-Betrachtung
- Power-Induktivität (DCDC)
- Überspannungsschutz
- Frequenzgebende Bauteile
- Schirmung
- Gehäuse
- Kabel

Nr. 3.9 Live EMV-Messung nicht isolierter DCDC-Wandler



- Gegenüberstellung gutes/schlechtes Design
- Layoutoptimierung
- Auswahl Speicherdrossel/Eingangskondensator (REDEXPERT)
- DM-Filterdesign
- Regelkreisstabilität (Middlebrook's Stabilitätskriterium)

Nr. 3.10 1-Phasen AC Filter



- Quellen der Störungen
- Bauteile zur Filterung
- Einstufen- und Zweistufenfilter
- Berechnung und Simulation
- Messungen der Störunterdrückung
- Y-Cap-Platzierung und PE-Anbindung
- Varistor- und TVSP-Berechnung
- Entladewiderstand für X-Caps

Nr. 3.11 3-Phasen AC Filter



- Quellen der Störungen
- Bauteile zur Filterung
- Filterdesign
- Y-Cap-Platzierung, Leckstrom und PE-Anbindung
- Berechnung und Simulation
- Messungen der Störunterdrückung
- Varistor-Berechnung und Platzierung

POWER

Nr. 4.0 Auswahl von Speicherdrosseln



- Broschüre „8 Design Tips“
- Kernmaterialien
- Geometrien, Luftspalt
- Verluste AC & DC
- Sättigungs- und Nennstrom
- Streufeld, Schirmring
- Simulation REDEXPERT
- Auswahl einer Speicherdrossel

Nr. 4.1 Wireless Power Transfer



- Was ist Wireless Power?
- Grundlegendes Prinzip
- Wireless Power Konsortium
- Formeln und Effizienz
- Spulen
- EMV
- Applikationen
- Markttrends

Nr. 4.2 Magl³C Power Modules



- Aufbau eines Power Moduls (DCDC-Wandler)
- Vorteile gegenüber einer diskreten Lösung
- Produktübersicht / Neuheiten
- Application Notes & Referenzdesigns
- Unterstützung und technischer Support

Nr. 4.3 Filtern von DC/DC Wandlern



- Filtern von Spannungswandlern
- EMV von Buck Mode LED Treibern

Nr. 4.4 Filtern von AC/DC Netzteilen



- EMV Anforderungen AC/DC SMPS
- Quellen der Störungen
- Bauteile
- Filterdesign und Dimensionierung
- Messungen von Entstörmaßnahmen
- Trafo Wicklungsdesign

Nr. 4.5 Energy Harvesting



1,5 h

- Was ist Energy Harvesting?
- Demoboard
- Anwendungsbeispiele

Nr. 4.6 EMV- und Effizienzoptimierung eines High Power DCDC-Netzteils



1,5 h

- Aufgabenstellung und Anforderungen
- Auslegung von 3 Designs
- Gegenüberstellung der 3 Designs
- Vergleich der EMV
- Effizienz und Temperaturentwicklung
- Zusammenfassung

Nr. 4.7 Live EMV-Messung isolierter DCDC-Wandler mit Entstörung (Flyback Demoboard)



2 h

- Typische Entstörmaßnahmen für AC/DC und DC/DC-Netzteile:
 - Grundlagen der Bauteilwahl (REDEXPERT)
 - Snubber
 - DM/CM-Filtermaßnahmen (DM/CM-Trennung)

Nr. 4.8 Flyback EMI/Power (Demoboard)



0,5 h

- CMC-Vergleich (Kernmaterial)
- Livemessungen

Nr. 4.9 GaN und SiC



1 h

- Vorteile von GaN/SiC
- Warum isolierte Gate-Treiber-Versorgungen?
- Isolierte Topologien für HV SiC/GaN Gate-Versorgungen
- EMV-Herausforderungen mit isolierten Topologien
- Layoutkonzepte und -beispiele
- Hochstrominduktivitäten für GaN-DCDC
- Zusammenfassung

SCHNITTSTELLEN

Nr. 5.0 Schnittstellen (Schutz und Filterung)



1,5 h

- Kommunikationsschnittstellen:
 - RS232 / RS422 / RS485
 - SPI, I²C, CAN
 - USB, SATA, Ethernet
- Videoschnittstellen:
 - LVDS
 - DVI / HDMI
 - DisplayPort (DP)

Nr. 5.1 USB 3.1 Gen x



0,75 h

- HF-Grundlagen
- Messungen

Nr. 5.2 Digitale Isolatoren



1 h

- Wieso galvanische Trennung?
- Grundlagen von Isolatoren
- Herausforderungen
- Spezielle Aspekte bei Isolatoren

Nr. 5.3 LAN-Transformer und PoE



1,5 h

- Grundlagen
- Power over Ethernet PoE
- HDBT und Spezialtypen

Nr. 5.4 Single Pair Ethernet (SPE)



1 h

- Geschichte von SPE
- Vorteile von SPE
- Weitere SPE-Standards
- SPE-Verkabelung
- SPE-Schnittstelle mechanisch
- SPE-Schnittstelle elektrisch
- Fremdspeisung
- PHY-Chips

Nr. 5.5 Battery Management System



0,5 h

- Grundlagen
- Bauteilinformationen
- Platzierung

FREQUENZ

Nr. 6.0 Design frequenzgebender Bauteile



1 h

- Allgemeines
- Komponenten und Parameter der Oszillatorschaltung
- Störquellen
- Design-in

ELEKTROMECHANIK

Nr. 7.0 Tipps und Tricks für Entwickler



- Erhöhung der mechanischen Stabilität von SMD-Bauteilen
- Haltekräfte von SMD-Spacern
- Stromtragfähige BtB- und WtB-Verbindungen mit TBL

Nr. 7.1 USB 3.x / USB Type-C aus elektromechanischer Sicht



- Mechanischer Aufbau
- Sonderfunktionen, Alternate Mode, Power Delivery (PD)
- Unterschiede zu bisherigen USB-Versionen
- Besonderheiten und Verarbeitung

Nr. 7.2 Leiterplattenklemmen im Einsatz



- Auswahlkriterien und Bemessung von TBL
- Unterschiede der Kabelfixierung
- Kleine Kabelkunde
- Belastung und Überlastung

Nr. 7.3 SCHALTER für Profis



- Erweiterte Auswahlkriterien und Charakteristik von Schaltern und Tastern
- Qualitätsmerkmale
- Schalten unterschiedlicher Lastarten
- Überblick IP-Rating und Waschbarkeit
- Prellen / Entprellen

Nr. 7.4 SMT Spacer



- Einführung
- Arten von SMT-Abstandshaltern
- Design und Verarbeitung
- Anwendungsbeispiele
- Ökonomischer Vergleich

Nr. 7.5 REDCUBE „Hochstromverbindungen“



- Grundlagen der PressFit-Einpresstechnik
- Mechanische und elektrische Eigenschaften
- Grundlagen SMD- und THR-REDCUBES
- **Workshop inkl. Kniehebelpresse und Platinen (+30 min)**

Nr. 7.6 Wärmemanagement



- Einführung
- Physikalische Grundlagen
- EMV-Sicht
- Allgemeine Anwendungsbeispiele
- Thermische Demo-PCB
- Thermische Simulation
- Sicherheitsaspekte
- Angebot von Materialien
- Testgeräte
- Einfluss der Kompression
- Musterbögen
- Services

Nr. 7.7 Luft- und Kriechstrecken



- Was ist elektrische Isolation
- Am häufigsten anwendbare Normen
- Regeln für Luft- und Kriechstrecken im PCB-Design
- Limits einzelner Produkte

Nr. 7.8 Funktion und Design von COAXIAL-Steckverbindern



- Grundlagen von COAX-Steckverbindern
- Grundlagen HF-Design
- Überblick zu Leiterplattenstrukturen
- Simulation von Steckverbindern und Leiterplatte

Nr. 7.9 HF-Verhalten von Stiftheisten



- Parameter und Darstellung
- Versuchsaufbau und Ziele
- Integration und Darstellung von Messergebnissen
- Optional in LTspice

Nr. 7.10 EMC with EMC



- GND-Konzepte
- Einkopplung und Abschirmung
- Kabel- und Boardverbindungen
- **Hinweis: Übergreifender Vortrag, bevorzugt in Kombination von eiSos- und eiCan-Referenten**

Nr. 7.11 Abschirmung und Abschirm-Materialien



- Rechtliche Anforderungen
- Abschirm-Konzepte – mechanische Betrachtung
- Schirmanbindung in Steckverbindern
- Abschirm-Materialien

Nr. 7.12 PoE – Power over Ethernet



- Welche Steckerkategorie für welchen PoE-Typ
- Temperaturanstieg im Steckverbinder
- Mechanische Stabilität von Modular Jacks („Hot Swap“)
- **Hinweis: Kombinierbar mit "5.3 LAN-Transformer und PoE"**

Nr. 7.13 Signalintegrität von Steckverbindern



- Pin- und Socket-Header
- Wire-to-Board 1 mm
- ZIF
- Grundlagen Impedanz / S-Parameter
- Testaufbau
- Augendiagramm
- Beispiele

Nr. 7.14 Kontakte und Kontaktoberflächen



- Materialien und Eigenschaften (Kunststoffe und Metalle)
- Einblicke in die Produktion
- Übergangswiderstand von Steckverbindungen
- Auswahlkriterien bei Steckverbindern
- **Hinweis: Entspricht einer Kombination von „7.15 Der elektrische Kontakt“ und „7.16 Kunststoffe und Elektrizität“ in Kurzfassung**

Nr. 7.15 Der elektrische Kontakt



- Definition Kontaktwiderstand
- Kontaktzone (Materialauswahl, A-Spots, Oberflächenbeschichtung, Korrosionsarten)
- Einflussfaktoren: Strom und Frequenzen
- Herstellungsverfahren

Nr. 7.16 Kunststoffe und Elektrizität



- Fertigung und Verarbeitung
- Mechanisches und elektrisches Verhalten
- Temperaturbeständigkeit
- Entflammbarkeit nach UL94 und Glow Wire
- REACH, RoHS, Halogenfreiheit

Nr. 7.17 Derating bei Steckverbindern



- Resultat von zu hohen Temperaturen
- Am häufigsten anwendbare Normen
- Grunderwärmung, Wärmeableitung
- Temperaturstabilität in Applikationen
- Stromspitzen durch Anlaufströme (Inrush)

Nr. 7.18 Crimpworkshop



- Definition Crimp
- Technische Parameter und Werkzeuge
- Beurteilung und Prüfung von Crimpverbindungen
- **Workshop: Crimpen und Crimpbewertung in der Praxis**

Nr. 7.19 Grundlagen zum Verguss von Baugruppen



- Materialien und Eigenschaften
- Vergusstechniken / -verfahren
- Aushärtung und Vernetzung
- Kritische Bauteile

Nr. 7.20 THR – Through Hole Reflow



- Anforderungen an ein THR-Produkt
- Layout- und Schablonenvorschläge
- Prozess und Stufen der Verarbeitung
- Qualitätskontrolle nach IPC-A-610D

FUNK UND SENSORIK

Nr. 8.0 Wireless Connectivity Basic



- Einführung in die Funktechnologie
- Grundlagen der Funkübertragung
- Frequenzbänder
- Netzwerktopologien
- Funkprotokolle
- Design-in: Hardware und Software
- Zertifizierungen

Nr. 8.1 Wie kann man mit Wireless starten?



- Grundlagen
- Funktechnologien
- HW- und SW-Integration
- Zertifizierungen

Nr. 8.2 MEMS Sensors Generalities + Signal Conditioning



- Einführung in die MEMS-Sensorik
- Grundlagen der MEMS-Technologie
- Sensoren im Wandel der Zeit
- Messtechnologie: Interaktion von Mechanik und Elektronik
- Sensorzelle versus Sensorsystem
- Design-Tipps

02

ECHTE EINBLICKE.
EXKURSIONEN
ZU UNSEREN
STANDORTEN.



WÜRTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT

ECHTE EINBLICKE, INDIVIDUELLER RAHMEN.

EXKURSIONEN ZU UNSEREN STANDORTEN.

Sie sind herzlich eingeladen, unsere Standorte zu erkunden, um Einblicke in den Berufsalltag zu bekommen. Bei der Gestaltung von Exkursionen gehen wir gerne auf Ihre Anfragen ein.

AUS FOLGENDEN BAUSTEINEN KÖNNEN SIE WÄHLEN:

Immer enthaltene Elemente

- Begrüßung inkl. Vorstellungsrunde
- Unternehmenspräsentation
inkl. Mehrwerte für Studierende/
Lehrende und Einstiegsmöglichkeiten
- Get-together

Zusätzliche Bausteine

Kompatibel mit allen Gastvorträgen und Workshops:

- Laborexperience
- Laborführung
- Besichtigung EMV Labor
- Lagerführung
- Erfahrungsbericht eines Young Talents
- Aufgabenbearbeitung (individuelle
Absprache nötig)



ZWEI EXKURSIONSMÖGLICHKEITEN.

IN UNSERE LABORE!



LABOREXPERIENCE

Kennenlernen unserer Kolleg:innen im Produktmanagement

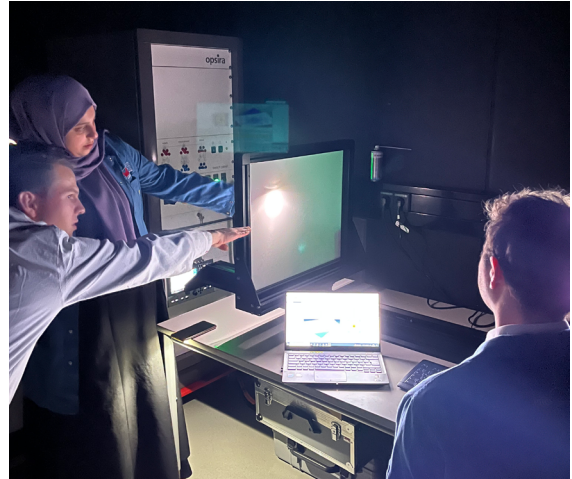
Tutor:innen & Young Talents

Workshop Produktlebenszyklus

- Aufgaben des Produktmanagements
- Produktlebenszyklus bei Würth Elektronik
- Aktiv Messungen an verschiedenen Stationen im Labor durchführen
- Messstation und Ergebnisse den anderen Stationen näher bringen
- Anforderungsprofil eines Produktes aufstellen

Laborführung

Umwelt- und Analyselabor



OPTOELEKTRONIK EXKURSION

Impulsvortrag Optoelektronik

Technologie, Forschung und aktuelle Kooperationen

Laborführung

Umwelt- und Analyselabor

Stationsdurchlauf mit Vorstellung unserer Messgeräte

- Spektralradiometrische Messungen in der Integration Sphere
- Ortsaufgelöste Messung optischer Parameter mit der Leuchtdichtekamera und 2π -Photogoniometer
- Neuartige LEDs mit integrierten Schaltkreisen
- Laserlabor

03

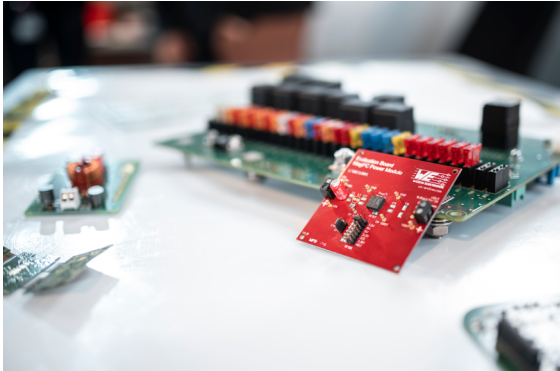
WISSEN GREIFBAR
VERMITTELN?

LEHRMATERIAL
UND TECHNISCHE
UNTERSTÜTZUNG.



WÜRTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT

ZUSÄTZLICHES LEHRMATERIAL ... **UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG.**



BAUTEILSTIPENDIEN **FÜR DIE LEHRE UND PRAXIS**

Kostenlose Bauteile für Ihre Vorlesungen / Unterricht, für Praktika, Abschlussarbeiten und für alle Anwendungen welche in Verbindung mit der Lehre stehen.



DESIGN KITS **FÜR LABORE**

Es handelt sich hierbei um einen Musterkoffer welcher mit Bauteilen unterschiedlicher Ausführung einer Produktgruppe gefüllt ist. Wir stellen solche Design Kits für Ihr Labor zur Verfügung.



TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG **VOR ORT**

Wir unterstützen mit dem technischen Außendienst und unseren Field Application Engineers Ihr Design-in und beraten mit unseren Bauteilen.



FACHBÜCHER ALS GEBUNDENE **AUSGABE**

Insgesamt stehen sechs Fachbücher zur Verfügung, welche die Anwender:innen praxisnah an die jeweiligen Themen heranführen und begleiten.

04

WISSEN KENNT
KEINE GRENZEN!

VIELFÄLTIGE
PROGRAMME FÜR
STUDIERENDE.

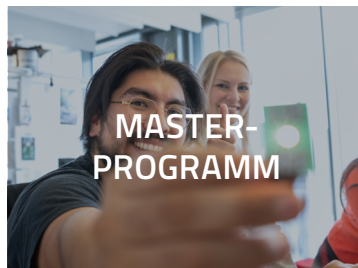


WÜRTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT

VOM HÖRSAAL AB INS UNTERNEHMEN. WÜRTH ELEKTRONIK ALS ARBEITGEBER.

UNSERE EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN

Ob IT, Vertrieb, technische oder kaufmännische Berufsfelder – bei Würth Elektronik können Studierende Praxiserfahrung sammeln und erste Kontakte zu einem internationalen Unternehmen aufbauen.



Auch für den Berufseinstieg bieten wir abwechslungsreiche Tätigkeiten, die schnell die Übernahme von Verantwortung ermöglichen. Vor allem aber eine Atmosphäre, die Spaß bei der Arbeit garantiert.

DAS BIETEN WIR

- Umfangreicher Einblick in die Aufgabenbereiche
- Vielfältige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Support durch eine:n Betreuer:in für die Zeit des Einsatzes sowie regelmäßige Feedbackgespräche
- Young Talent Stammtische und Events
- Fahrtkostenzuschuss
- Gesundheitsprogramm WEtality
- Teilnahme an Firmenincentives
- Teilnahme an Seminaren und Workshops



Mehr Infos?

we-online.com/karriere



UNSER SPIRIT: IT'S ABOUT PEOPLE

Wie arbeiten wir?

Wir lieben Fragen und pflegen eine positive Fehlerkultur, denn wir können Neues nur ausprobieren, wenn wir bereit sind, die Initiative zu ergreifen und aus Fehlern zu lernen.

Wie unterstützen wir?

Wir fordern und fördern alle Mitarbeiter:innen individuell und unterstützen ihre Weiterentwicklung auf Ebene der Persönlichkeit und der fachlichen Kompetenz. Wir möchten Orientierung geben und die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln.

Wie gehen wir miteinander um?

Gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit und Fairness ist unsere Grundhaltung. Wir pflegen ein freundschaftliches Miteinander und bauen Beziehungen zueinander auf.

Kommen Sie gerne auf uns zu,
um Möglichkeiten zu besprechen:
University.Marketing@we-online.de



WÜRTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT